

臺北市政府教育局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號
承辦人：賴美芬
電話：02-27208889轉6361
電子信箱：bw5969@gov.taipei

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國113年5月15日

發文字號：北市教中字第1133060325號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金點設計獎報名簡章及介紹各1份 (31669488_1133060325_1_ATTACHMENT1.pdf、
31669488_1133060325_1_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：函轉財團法人台灣設計研究院辦理「2024金點設計獎」一案，請查照。

說明：

- 一、依據本府產業發展局113年5月7日北市產業工字第1130119395號函及財團法人台灣設計研究院（以下簡稱設計研究院）113年5月2日臺設字第1131001213號函辦理。
- 二、旨案「2024金點設計獎」係由經濟部指導，經濟部產業發展署主辦，設計研究院執行之國際級設計獎賽，旨在促進設計產業發展，鼓勵企業重視設計與研發，以設計力增加品牌的附加價值，更為消費者與市場提供優質設計的認證，進而提升全民對於設計價值與設計美學的認知，共同創造美好生活品質。
- 三、「2024金點設計獎」訂於6月26日（三）截止收件，相關細節請詳見附件介紹及報名簡章，或洽設計研究院聯繫窗口何婉慈（電話：2745-8193轉343、電子信箱：sarah_ho@tdri.org.tw）。



四、檢附獎賽介紹及簡章詳如附件。

正本：臺北市政府教育局所屬公立高級中學及高級職業學校、臺北市私立高級中學及高級職業學校

副本：



裝

訂

線

